



Автоматическая субмикронная монтажная станция FINEPLACER femto 2



Область применения:

- Монтаж по методу Flip Chip (face down)
- Высокоточный монтаж кристаллов (face up)
- Монтаж лазерных диодов, лазерных линеек
- Монтаж VCSEL-, фотодиодов
- Монтаж светодиодов
- Монтаж микрооптических элементов
- Монтаж МЭМС и датчиков
- Трёхмерная компоновка
- Монтаж на уровне пластины (W2W, C2W)
- Монтаж по технологиям Chip on Glass / Chip on Flex

Поддерживаемые технологии:

- Термокомпрессионный, термозвуковой и ультразвуковой монтаж
- Пайка (AuSn, C4, индий, на уровне эвтектической точки)
- Адгезионные технологии
- Термостабилизация при помощи УФ, нагрева
- Монтаж по технологии Copper Pillar
- Пайка кристаллов со столбиковыми выводами
- Монтаж механическим путём
- Распознавание образов для автоматических процессов позиционирования и монтажа
- Высокое оптическое разрешение при большом поле зрения
- Интегрированное управление процессами (IPM)
- IPM Command: программное обеспечение нового поколения на базе библиотеки
- Оперативная камера наблюдения за процессами
- Почти неограниченный спектр передовых монтажных технологий



Параметры	FINEPLACER femto 2
Точность позиционирования	± 0,5 мкм
Поле обзора	3,8–2,7 мм
Максимальный размер кристалла	100 x 100 мм
Максимальный размер подложки	500 x 300 мм
Область размещения	450 x 150 мм
Перемещение по оси X / точность	450 мм / 0,1 мкм
Перемещение по оси Y / точность	150 мм / 0,1 мкм
Перемещение по оси Z / точность	10 мм / 0,2 мкм
Поворот по углу Θ / точность (макс)	± 9° / 0,0002°
Минимальная сила прижима	0,2 N (0,1 N)
Максимальная сила прижима	20 N (500 N)
Максимальная скорость нагрева	20 К/сек (100 К/сек)
Максимальная температура	400 °C (500 °C)
Точность удержания температуры	± 1 %

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

*Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники*